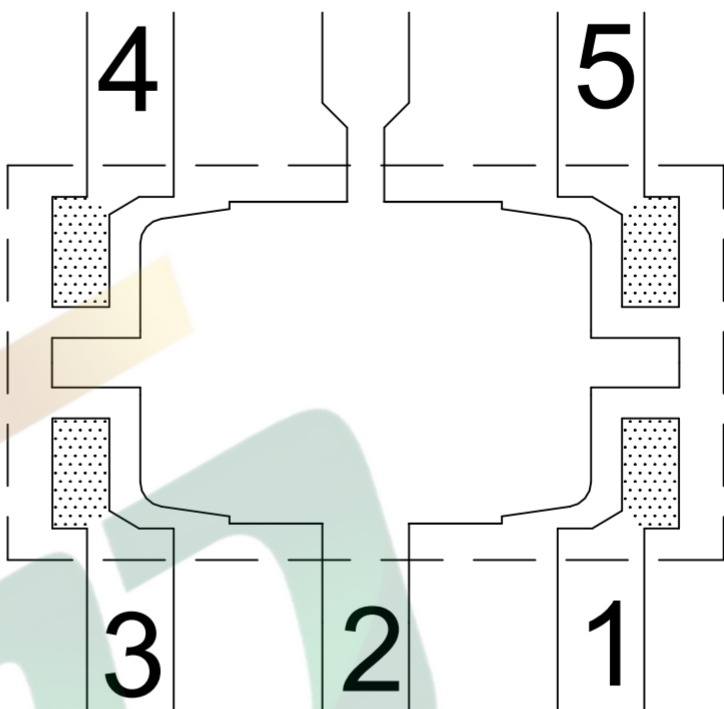




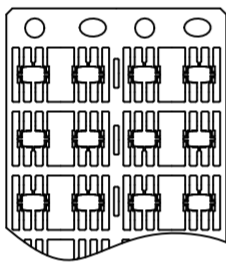
上海季丰电子科技有限公司

GIGA FORCE ELECTRONICS CO., Limited

压焊图名称 BD Name	
图纸版本 Version No.	
压焊图编号 BD No.	
客户代码 Customer No.	
产品型号 Device Name	
封装形式 PKG Type	SOT23-5
LF载体尺寸 Die Pad Size	1295um*1828um
焊线类型1 Wire Type	
焊线类型2 Wire Type	
焊线条数 Wire QTY	
塑封料型号 Compound Type	



椭圆孔在上方



——▶ 框架进料方向

备注

	芯片名称 Die Name	芯片尺寸 Chip Size	装片胶类型 Glue Type	晶圆厚度 Chip thickness	晶圆尺寸 Wafer Size	切割道宽 Glue Type	焊盘尺寸 Pad Size	焊点间距 Pad Pitch	铝垫厚度(um) Pad Thickness	PAD下有无电路 IF CUP PAD
Die1:										
Die2:										
Die3:										

版本 Rev.	变更历史 Change History	日期 Date

Mark规范

制图 Create:	审核 Review:	批准 Approve:	客户确认 Customer Approve: